

会場案内図・出展者リスト・セミナー・イベントガイド

JPCA 2026 Show
第55回国際電子回路産業展

JIEP 2026
マイクロエレクトロニクスショー
第40回 最先端実装技術・パッケージング展

JISSO PROTEC 2026
第27回 実装プロセステクノロジー展

AI Device Expo
AIデバイス展

WIRE Japan Show 2026
電気・光伝送技術展

Electronics Component & Unit Show
JEP 全国電子部品流通連合会
東京電子機器商協同組合

E-Textile/Wearable
イーテキスタイル/ウェアラブル展

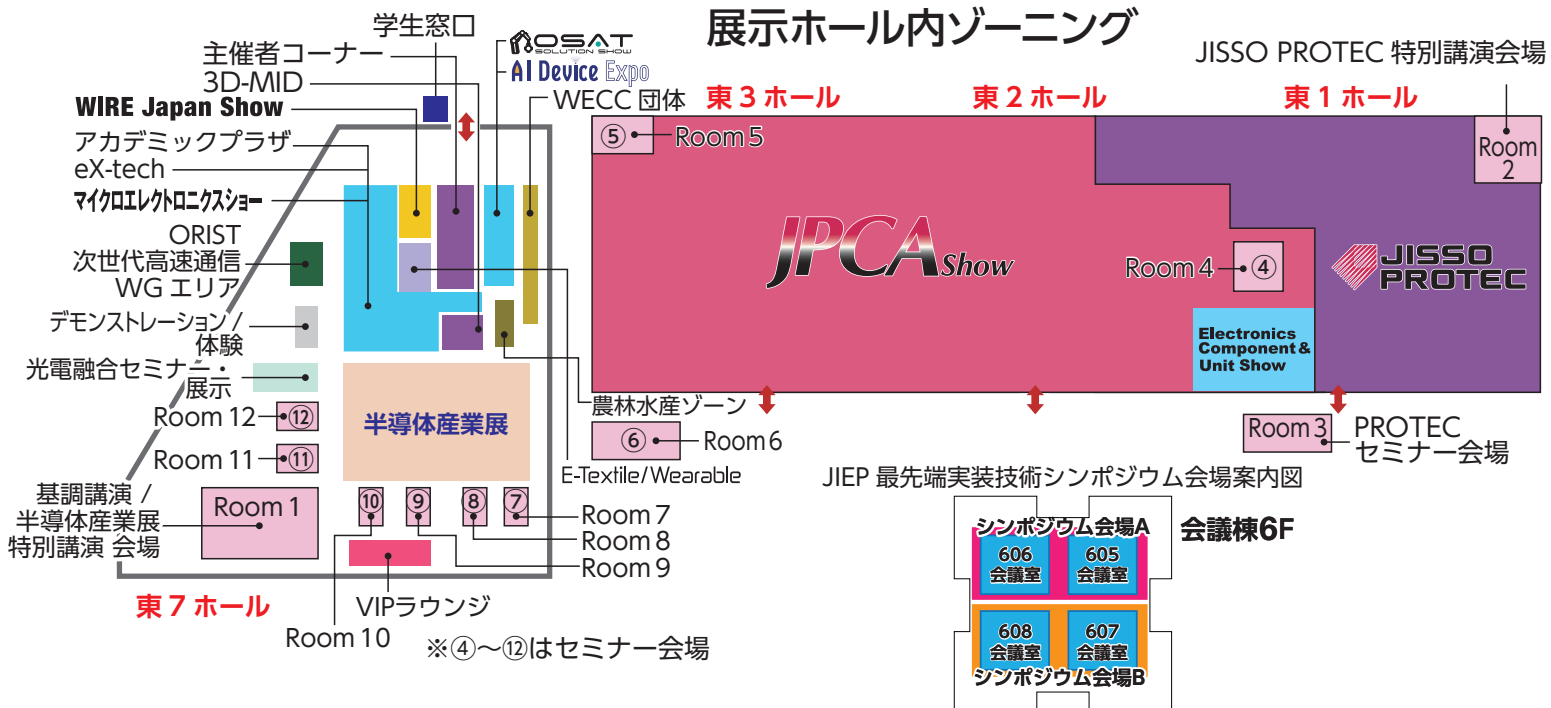
半導体産業展

OSAT SOLUTION SHOW

電子機器2026 トータルソリューション展

2026.6.10 Wed. → 12 Fri. 10:00-17:00

東京ビッグサイト東展示棟・会議棟



PLATINUM スポンサー

MEIKO **V-TECHNOLOGY**

GOLD スポンサー

mks | Atotech | ESI **Dynatron**

太陽インキ製造 **AKOKKI** **MMEC**

SILVER スポンサー

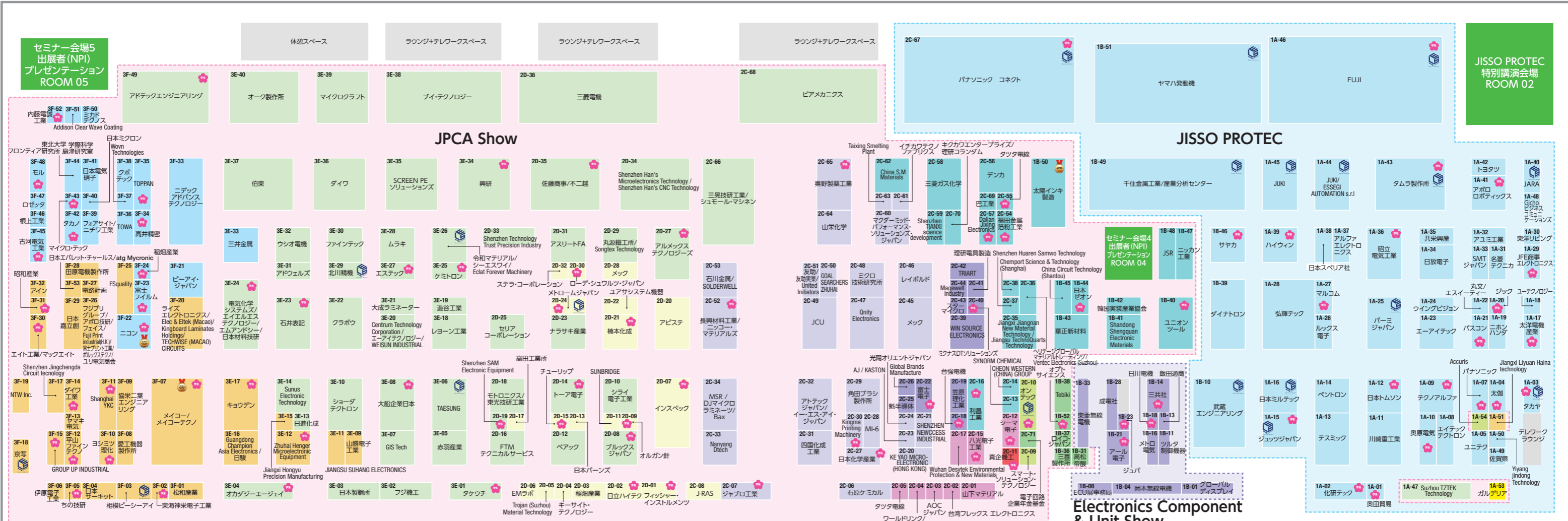
KYOSHA **KYODEN GROUP** **タカノ株式会社**

BRONZE スポンサー

nikhan **IHARA** **TOA MUSEN DENKI** **HIWIN** **JEP** **FUJIFILM** **SCREEN**

ISHIHYAKI **OKUDA** **MUSASHI** **mtco.** **gaot** **大洋電機産業** **JUKI** **WINSOURCE**

奥田貿易株式会社 名菱テクニカ株式会社 名菱電機産業



エリア凡例

JPCA Show

- 製品(電子回路基板等の電子機器)
- 設計技術
- 信頼性・検査技術
- 主材料・絶縁技術
- 機能材料・プロセス材料・資機材
- 製造装置・設備
- 物流システム
- 環境システム
- その他
- 半導体パッケージング・部品内蔵技術展
- フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
- 機器・半導体受託生産システム展

JISSO PROTEC

Electronics Component & Unit Show

来場者参加型企画

ブースコンテスト【投票コーナー：東7ホール】

皆様、ブース投票にご参加下さい!!

【投票期間】6月10日(水)・11日(木)

ブースコンテストを今年も開催!

【ナイスデザイン賞】はご来場の皆様の投票で決めます!

投票していただいた皆様には粗品を進呈いたしますので、ぜひご参加下さい。

6月12日(金) AM10:15~10:30 東7ホール セミナー会場11にて受賞式を行います。

ぜひ、ご参集ください!

学生向けオリエンテーション&ツアー

(各日先着10名) 留学生の方も大歓迎!

毎日10:30~11:30に展示会の見どころに関するオリエンテーションとツアーを開催いたします。(オリエンテーション実施場所: 東3ホール セミナー会場6)

※事前に学生窓口(東7ホール前)での受付をお済ませください。

また「学生ウェルカムブース」を展示会公式ウェブサイトに掲載していますのでご覧ください。

学生ウェルカムブースマーク

第22回 JPCA 賞 (アワード)

【表彰式】 セミナー会場7 6月10日(水) 16:40~17:00 (社名五十音順)

この度、JPCA賞(アワード)選考委員会にて、厳正なる審査の上、第22回JPCA賞(アワード)受賞企業が下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。

JPCA賞(アワード)は、参加企業の中から、応募のあった発表内容の「獨創性(独自性・オリジナリティ)」、「産業界での発展性・将来性」、「信頼性」、「時々の適合性」を審査基準として、学界界、電子回路業界、専門誌編集者等有識者の方々で構成するJPCA賞(アワード)選考委員会によって厳正なる審査を行い、電子回路技術及び産業の進歩発展に顕著な製品・技術への表彰制度として2005年より実施しています。

JPCA賞	ガラス貫通基板の新規導電層形成工法となるめっきプライマー材料の開発	株式会社イオックス【小間番号:7G-01】
JPCA奨励賞	PAP(Photo Assist Patterning)光応答性表面処理材料を用いた難めっき基板への回路形成技術	株式会社ニコン【小間番号:3F-22】
	アルミ配線多層基板	株式会社メイコー【小間番号:3F-07】
	世界初の無溶剤型絶縁剤を選択的に高速塗布可能な塗布システム	Shimada Appli 合同会社【小間番号:eX-17】
	次世代高速通信基板向け穴埋めインキ	太陽インキ製造株式会社【小間番号:1B-50、7C-28/29】

半導体・オブ・ザ・イヤー 2026

【表彰式】 セミナー会場10 6月10日(水) 14:00~

半導体オブ・ザ・イヤー2026は、2025年4月~2026年3月の間に発表された新製品・新技術の中から産業タイムズ社にて厳正に選出いたしました。

半導体デバイス部門		半導体製造装置部門		半導体用電子材料部門	
グランプリ	NVIDIA	グランプリ	Vanguard Automation GmbH Mycronic Group	グランプリ	大日本印刷株式会社
優秀賞	キオクシア株式会社 Rapidus 株式会社	優秀賞	株式会社ニューフレアテクノロジー 日機装株式会社	優秀賞	富士フイルム株式会社 奥野製薬工業株式会社

2026 アカデミックプラザ受賞者

【表彰式】 セミナー会場9 6月10日(水) 16:40~17:00

アカデミックプラザで発表される研究発表論文の中から、JIEP 展示会委員会(地域委員長:東京工芸大学 工学部 総合工学系 電気電子コース、大学院 工学研究科 電子情報工学専攻、基礎教育研究センター 教授)で優秀な論文内容が選考され、アカデミックプラザ賞受賞者が決定いたしました。

アカデミックプラザ賞	低温ヘテロジニアス集積のためのAu薄膜転写を応用した接合面の平滑化およびマイクロバンプ接合の研究	東北大学 大学院工学研究科 電子工学専攻
	USB2.0通信の電磁的情報漏洩実験系の構築と盗聴防止を目的とした漏洩メカニズムの解明	岡山大学大学院環境生命自然科学研究科 / 自然科学学域
	プリント基板のCuダイレクトレーザピアホール加工における絶縁層ガラスロス2枚積層が加工穴直径に与える影響に関する考察	同志社大学大学院理工学研究科 / 理工学部
	左右ボールねじカウンタバランス制振機構を有する穴あけ工作機械によるプリント基板のマイクロドリル加工におけるサイクルステップ動作の検討	同志社大学大学院理工学研究科 / 理工学部
	スイッチング電源など開回路の導線内循環電流について	信州大学 工学部 工学科 電気電子コース 高効率電力システム研究室 (HePS)
アカデミックプラザ5年連続賞	信州大学 工学部 工学科 電気電子コース 高効率電力システム (曾根原) 研究室	

出展者リスト

2026年6月1日(月) 現在 (展示会別・五十音順・法人格省略)

JPCA Show	
プリント配線板技術展	
国内	
あ 愛工機器製作所	3F-08
アイ	3F-32
赤羽産業	3E-05
アスリート FA	2D-31
アドウェルズ	3E-31
アドテックエンジニアリング	3F-49
アトテックジャパン	2C-32
アピステ	2D-20
アポロ技研	3F-26
アルメックステクノロジーズ	2D-27
ANVOS Analytics	7G-01
アントンパール・ジャパン	7G-01
イー・エス・アイ・ジャパン	2C-32
EM ラボ	2D-06/ 7G-01
イーマキーナ	7B-06
イオックス	7G-01
石井表記	3E-23
石川金属	2C-53
石原ケミカル	2C-06
イチカワテクノファブリティクス	2C-61
稲畑産業	2D-03
伊原電子工業	3F-06
インスペック	2D-07
ウシオ電機	3E-32
エイエルエステックロジー	3E-24
エイト工業	3F-30
エーアイテクノロジー	3E-20
AJ	2C-23
エステック	3E-27
NTW inc.	3F-19
FTM テクニカルサービス	2D-16
MI-6	2C-28
エムアンドシー	3E-24
MSR	2C-34
お オーク製作所	3E-40
大阪産業技術研究所	7G-01
大船企業日本	3E-08
オカダジーエージェイ	3E-04
奥野製業工業	2C-65
オプトロニクス社	7H-12
オルガン針	2D-09
オンテック	2C-10
か 化学工業日報社	7H-10
華正新材料	1B-43
ガルデリア	1A-53
き キーサイト・テクノロジー	2D-04
キクカワエンタープライズ	2C-70
北川精機	3E-29
Qnity Electronics	2C-47
協栄二葉エンジニアリング	3F-09
京写	3F-18
京セラ	7C-01
キョウデン	3E-17
く クオルテック	7G-01
楠本化成	2D-21
熊本県	7B-05
クラブオウ	3E-22
ケミترون	3E-25
こ 興研	3E-34
光陽オリエントジャパン	2C-24
さ 堺化学工業	7F-01
相模ピーシーアイ	3F-03
佐藤商事	2D-35
山栄化学	2C-64
三喜製作所	1B-36
三晃技研工業	2C-66
SUNBRIDGE	2D-11
シーエスワイ	3E-26
JSR	1B-48

J-RAS	2C-08
JCU	2C-49
四国化成工業	2C-31
澁谷工業	3E-19
ジャブロ工業	2C-07
松和産業	3F-01
昭和産業	3F-31
ショーダテクトロン	3E-10
シライ電子工業	2D-10
信越化学工業	7C-05
真企機工	2C-11
新興電気	2C-68
新タック化成	7G-01
す SCREEN PE ソリューションズ	3E-35
ステラ	2C-68
ステラ・コーポレーション	2D-32
スマート・ソリューション・テクノロジー	2C-09
住友化学	7G-01
青電舎	7B-06
セリアコーポレーション	2D-25
大成ラミネーター	3E-21
太陽インキ製造	1B-50
ダイワ	3E-36
ダイワ工業	3F-14
高田工業所	2D-17
高松帝酸	1B-31
タケウチ	3E-01
タツタ電線	2C-55
田原電機製作所	3F-28
ちの技研	3F-05
チューリップ	2D-15
長興材料工業	2C-52
つ 角田プラン製作所	2C-29
て ティ. エム. ワークス/鹿ソニック	7B-06
Tebiki	1B-38
デンカ	2C-56
電気化学システムズ	3E-24
電子回路企業年金基金	2C-71
電路計画	3F-27
と 東海神栄電子工業	3F-02
東京マシン・アンド・ツール	2C-68
東光技研工業	2D-18
東朋テクノロジー	2C-68
トーマ電子	2D-14
巴工業	2C-69
な ナラサキ産業	2D-23
に 日亜化学工業	7G-01
ニッカン工業	1B-47
日刊工業新聞社	7H-11
ニッコー・マテリアルズ	2C-52
日駿	3E-16
日進化成	3E-13
日本化業	7G-01
日本ゼオン	1B-44
ニフコ	7H-09
日本エパレット・チャールス	3F-53
日本化学産業	2C-27
日本サーキット	3F-04
日本材料技研	3E-24
日本轟立創	3F-29
Fuji Print industrial(H.K.)	3F-26
G GIS Tech	3E-07
Global Electronics Association (GEA)	7A-04
GOAL SEARCHERS ZHUHAI	2C-50
GROUP UP INDUSTRIAL	3F-15
Guangdong Champion Asia Electronics	3E-16
Guangdong Chengde Electronic Technology	3F-27
H Hong Kong Printed Circuit Association (HKPCA)	7A-05
J JIANGSU SUHANG ELECTRONICS	3E-11
Jiangsu TechnoQuarts Technology	2C-35
Jiangxi Hongyu Precision Manufacturing	3E-15
Jiangxi Jiangnan New Material Technology	2C-35
Jiangxi Liyuan Haina Technology	1A-51

フェイス	3F-26
福田金属箔粉工業	2C-54
フジ機工	3E-02
不二越	2D-35
フジブリグループ	3F-26
富士プリント工業	3F-26
古河電気工業	7G-01
ブルックスジャパン	2D-08
へ ベアック	2D-12
ヘリテージグローバルマテリアルレーディング	2C-36
ポルックステクノ	3F-26
マイクログラフト	3E-39
マクセル	7C-04
マクセルフロンティア	7B-06
マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン	2C-60
マジレリカ・ジャパン	7G-01
スマート・ソリューション・テクノロジー	7G-01
松尾産業	7G-01
マックエイト	3F-30
丸源鐵工所	2D-29
み ミクロ技術研究所	2C-48
三菱ガス化学	2C-58
三菱電機	2D-36
ムラキ	3E-28
め メイコー	3F-07
メイコーテクノ	3F-07
メック (兵庫)	2C-45
メック (神奈川)	2D-28
メトロームジャパン	2D-24
モトロニクス	2D-18
も や 山勝電子工業	3E-09
ヤマキ電気	3F-13
ゆ ユアサシステム機器	2D-22
友助	2C-51
ユニオンツール	1B-40
ユニチカ	7G-01
ユリ電気商会	3F-26
よ ヨシミツ理化	3F-10
ら ライズエレクトロニクス	3F-20
り 理研コランダム	2C-70
利昌工業	2C-16
レイボルド	2C-46
令和マテリアル	3E-26
レヨン工業	3E-18
ろ ロイコ・ジャパン	1B-37
ローデ・シュワルツ・ジャパン	2D-30

海外

A Accuris	1A-54
atg Mycronic	3F-53
C Centrum Technology Corporation	3E-20
Chemport Science & Technology (Shanghai)	2C-38
CHEON WESTERN (CHINA) GROUP	2C-14
China Circuit Technology (Shantou)	7G-01
China Printed Circuit Association (CPCA)	7A-02
China S.M Materials Corporation	2C-62
D Dalian Jixing Electronics	2C-57
DJ MicroLaminates	2C-34
E Eclat Forever Machinery	3E-26
Elec&Etek (Macao)	3F-20
F FSquality	3F-25
Fuji Print industrial(H.K.)	3F-26
G GIS Tech	3E-07
Global Electronics Association (GEA)	7A-04
GOAL SEARCHERS ZHUHAI	2C-50
GROUP UP INDUSTRIAL	3F-15
Guangdong Champion Asia Electronics	3E-16
Guangdong Chengde Electronic Technology	3F-27
H Hong Kong Printed Circuit Association (HKPCA)	7A-05
J JIANGSU SUHANG ELECTRONICS	3E-11
Jiangsu TechnoQuarts Technology	2C-35
Jiangxi Hongyu Precision Manufacturing	3E-15
Jiangxi Jiangnan New Material Technology	2C-35
Jiangxi Liyuan Haina Technology	1A-51

K KASTON	2C-23
KE YAO MICRO-ELECTRONIC (HONG KONG)	2C-20
Kingboard Laminates Holdings	3F-20
Kingma Printing Machinery	2C-30
Korea Packaging Integration Association (KPIA)	1B-42
Korea Semiconductor Packaging and Circuits Association (KPCA)	7A-06
N Nanyang Dtech	2C-33
S Schmoll maschinen GmbH	2C-66
Shandong Shengquan Electronic Materials	1B-41
Shanghai YKC	3F-11
Shenzhen Han's CNC Technology	2D-34
Shenzhen Han's Microelectronics Technology	2D-34
Shenzhen Huaren Samwo Technology	2C-37
Shenzhen Jingchengda Circuit tecnology	3F-17
SHENZHEN NEWCESS INDUSTRIAL	2C-21
Shenzhen SAM Electronic Equipment	2D-19
Shenzhen Technology Trust Precision Industry	2D-33
ShenzhenTIANXI science development	2C-59
SOLDERWELL	2C-53
Songtex Technology	2D-29
Sunus Electronic Technology	3E-14
Suzhou TZTEK Technology	1A-47
SYNORM CHEMICAL	2C-13
T TAESUNG	3E-06
Taiwan Printed Circuit Association (TPCA)	7A-09
Taixing Smelting Plant	2C-63
TECHWISE (MACAO) CIRCUITS	3F-20
Thailand Printed Circuit Association (THPCA)	7A-08
Trojan (Suzhou) Material Technology	2D-05
United Initiators	2C-51
V Ventec Electronics (Suzhou)	2C-36
W WEISUN INDUSTRIAL	3E-20
Y Yiyang jindong Technology	1A-50
Youzhu Industry	2C-51
Z Zhuhai Henger Microelectronic Equipment	3E-12

3D-MID/バヒリオン

国内	
い 岩手県工業技術センター	7C-25
す 図研	7C-24
た 太陽インキ製造	7C-28/29
れ 日本 MID 協会	7C-26/27

半導体パッケージング・部品内蔵技術展	
国内	
い 稲畑産業	3F-24
う Wovn Technologies	3F-37
お オプトサイエンス	1B-52
く クボテック	3F-38
た タカノ	3F-42
と 東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室	3F-44
TOWA	3F-36
TOPPAN	3F-35
な 内藤電誠工業	3F-52
に ニコン	3F-22
ニチフ工業	3F-39
日本電気硝子	3F-41
ニテックアドバンステクノロジー	3F-33
日本ミクロン	3F-40
根上工業	3F-46
は パナソニック インダストリー	7C-03
ひ ピーアイ・ジャパン	3F-21
ふ フォアサイト	3F-39
富士フイルム	3F-23
古河電気工業	3F-45
マイクロ・テック	3F-43
ま ミカドテクノス	3F-50
み 三井金属	3E-33
も モル	3F-48
ろ ロゼッタ	3F-47

海外	
A Addison Clear Wave Coating	3F-51
T TAKAI Precision	3F-34

フレキシブルプリント配線板製品出展エリア	
国内	
え AOCジャパン	2C-03
し シーマ電子	2C-12
た タツタ電線	2C-05
は 八光電子工業	2C-15
む 村田製作所	7C-02
や 山下マテリアル	2C-01
わ ワールドリンク	2C-04
海外	
P Photonics-Systems-Group	2C-04
T taiwan flex electronics	2C-02
Wuhan Desytek Environmental Protection & New Materials	2C-17

機器・半導体受託生産システム展	
国内	
か 笠原理化学工業	2C-19
さ 魁半導体	2C-25
す スターマイクロ	2C-43
と TRIART	2C-42
ふ 富士電子	2C-22
み ミクナス DT ソリューションズ	2C-40
り 理研電具製造	2C-41
海外	
G Global Brands Manufacture	2C-26
M Magewell Industry	2C-44
T TAI CHYANG ELECTRIC ENG	2C-18
W WIN SOURCE ELECTRONICS	2C-39

マイクロエレクトロニクスショー

え エレクトロニクス実装学会 (JIEP)	7C-23
さ サンエナジー	7C-06

eX-tech	
あ 愛知製鋼	eX-07
アイテス	eX-16
I-PEX	eX-04
秋田化学工業	eX-39
actnano Inc	eX-21
アシストナビ	eX-02
アテネ	eX-12
アンドールシステムサポート	eX-24/25
う ウシオ電機	eX-06
え エスペース	eX-33
EGGHEAD	eX-20
エレファンテック	eX-08
エンジニアリング・ラボ	eX-34
お 大阪有機化学工業	eX-10
奥野製業工業	eX-42
オジックテクノロジーズ	eX-03
か カネカテクノリサーチ	eX-35
け CHEMIPAZ	eX-09
こ 江東電気	eX-13
こジマプラスチックス	eX-05
さ サーモグラフィティクス	eX-28
し JNC 石油化学	eX-26
JSOL	eX-19
Shimada Appli	eX-17
新菱	eX-18
た 太洋工作所	eX-22
て TDK	eX-27
ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン	eX-30
TEGソリューション	eX-38
テクニトロン・サブライ	eX-23
電気印刷研究所	eX-37
電子技研	eX-14
と 東洋紡	eX-41
な 長瀬産業	eX-40
に 日邦産業	eX-32
日本高純度化学	eX-15
の ノードソン	eX-11
は パナック	eX-31
ハニー化成	eX-43
ふ FUJI	eX-36
プラズマイオンアシスト	eX-29
ゆ ユー・コーポレーション	eX-01

アカデミックプラザ	
あ 秋田大学	7E-15
足利大学	7F-09
お 大阪公立大学	7E-02
大阪公立大学大学院工学研究科	7E-03
大阪産業技術研究所	7E-01
岡山大学 工学部 情報・電気・数値データサイエンス系	7F-06
か 神奈川県立産業技術総合研究所	7F-13
き 九州大学	7F-08
く 群馬大学	7F-10
群馬大学大学院 理工学府	7F-11
こ 甲南大学	7F-07
し 徳島大学 工学部 高効率電力システム (徳島県) 研究室 / Epulse	7E-05
徳島大学 工学部 高効率電力システム (徳島県) 研究室 / Epulse	7E-06
す 崇城大学	7F-04
て 電磁材料研究所	7E-10
と 東京電機大学	7E-14
東京理科大学	7E-12
東京理科大学 山本研究室	7E-11
東北大学 遠藤 (恭)・室賀研究室	7F-02
東北大学	7F-01
東北大学 日暮研究室	7F-03
富山県立大学	7F-05
な 長野工業高等学校 高速信号伝送評価センター	7E-08
長野工業高等学校 中山研究室	7E-07
に 日本大学 金子研究室	7E-09
日本大学理工学部精密機械工学科	7E-13
や 山形大学 フレキシブル基盤技術グループ	7E-16
よ 横浜国立大学	7F-14

JISSO PROTEC

国内	
あ アポロロボティクス	1A-41
アユミ工業	1A-32
アルファエレクトロニクス	1A-37
ウイングビジョン	1A-24
え エイテックテクトロン	1A-08
エーアイテック	1A-23
エスイーティー	1A-22
SMTジャパン	1A-33
お 奥田貿易	1A-01
奥原電気	1A-10
か 化研テック	1A-02
川崎重工業	1A-11
き Gicho ビジネスコミュニケーションズ	1A-48
共栄興産	1A-35
こ 弘碑テック	1A-28
さ 佐賀県	1A-49
サヤカ	1B-46
産業分析センター	1B-49
し JFE 商事エレクトロニクス	1A-29
ジック	1A-20
JUKI	1A-44/45
ジュッツジャパン	1A-15
昭立電気工業	1A-36
せ 千住金属工業	1B-49
た 太加	1A-04
ダイナトロン	1B-39
太平洋電機産業	1A-17
タカヤ	1A-03
タムラ製作所	1A-43
テクノアルファ	1A-09
テスミック	1A-13
と 東洋リビング	1A-30
トヨタツ	1A-42
に 日放電子	1A-34
日本トムソン	1A-12
日本スペリア社	1A-38
ニホンハンダ	1A-19
日本ミルテック	1A-16
日本ロボット工業会 (JARA)	1A-40
は パーミジャパン	1A-25
ハイウィ	1A-39
パスコ	1A-21

パナソニック	1A-07
パナソニック コネクト	2C-67
ふ FUJI	1A-46
ま マルコム	1A-27
丸文	1A-22
む 武蔵エンジニアリング	1B-10
め 名菱テクニカ	1A-31
や ヤマハ発動機	1B-51
ゆ ユーテクノロジー	1A-18
ユニテック	1A-05
る ルックス電子	1A-26
海外	
E ESSEGI AUTOMATION	1A-44
P ペントロン	1A-14

AI Device Expo

く グロスパーク	7B-08
さ 産業タイムズ社	7B-09
て Tellus	7B-08

WIRE Japan Show	
国内	
て 電線新聞社	7D-40
に 日本コーティングセンター	7D-04
ほ ホースパワージャパン	7D-01
海外	
H Huzhou Shantian Motor	7D-01
K Kunshan Dayang Printed Circuit Board	7D-01
S SHENZHEN EAST-TOPTECH	7D-03
T Taymer International	7D-02

Electronics Component & Unit Show

あ アール電子	1B-21
い 飯田通商	1B-13
お 岡本無線電機	1B-04
く グローバルディスプレイ	1B-01
さ 三共社	1B-14
し ジュパ	1B-23
せ 成電社	1B-28
全国電子部品流通連合会 (JEP)	1B-08
つ ツルタ制御機器	1B-11
と 東亜無線電機	1B-33
東京都電機卸商業協同組合 (TEP)	1B-08
ひ 日川電機	1B-18
め メトロ電気	1B-16

E-Textile/Wearable

あ AZAYAKA JAPAN	7D-08
え ENEOS テクノマテリアル	7D-17
ME テック	7D-05
お 大塚テクノ	7D-12
か カラキ	7D-13
さ 三機コンシス	7D-07
て t-テキスタイル製品化研究会	7D-20
と ToI Nexus	7D-09
東京都立産業技術研究センター	7D-19

電子機器トータルソリューション展 基調講演 無料 要事前登録 東7ホール 基調講演会場

Table with 3 columns for dates 6月10日(水), 6月11日(木), 6月12日(金). Topics include semiconductor industry trends, AI era challenges, and advanced packaging technologies.

半導体産業展 特別講演 無料 要事前登録 東7ホール 半導体産業展特別講演会場

Table with 2 columns for dates 6月11日(木) and 6月12日(金). Topics include semiconductor policy, industry history, and future prospects.

JIEP 最先端実装技術シンポジウム 有料 要事前登録 会議棟6F 最先端実装技術シンポジウム A会場・B会場

聴講するには事前登録のうえ、聴講料の支払いが必要です (VIP登録された場合も有料です)。会員区分によって聴講料が異なります。詳細・登録はHPよりご確認ください。

Table with 2 columns for A会場 (会議棟605・606) and B会場 (会議棟607・608). Topics include high-frequency materials, AI era packaging, and advanced packaging technologies.

Table with 2 columns for A会場 (会議棟605・606) and B会場 (会議棟607・608). Topics include high performance/high density packaging, AI era packaging, and advanced packaging technologies.

Table with 2 columns for A会場 (会議棟605・606) and B会場 (会議棟607・608). Topics include 3D packaging technology, advanced packaging, and AI era packaging.

PWBコンサルタントによるセミナー 有料 要事前登録 会議棟609

Table with 2 columns for dates 6月10日(水) and 6月12日(金). Topics include multi-layer PCB manufacturing, board environment, and quality assurance.

JISSO PROTEC 特別講演 無料 要事前登録 東1ホール JISSO PROTEC 特別講演会場

Table with 3 columns for dates 6月10日(水), 6月11日(木), 6月12日(金). Topics include smart devices, GEA introduction, and JEITA roadmap.

PROTECセミナー 無料 事前登録不要 ※各社の申し込み方法に準じます 東1ホール PROTECセミナー会場

Table with 3 columns for dates 6月10日(水), 6月11日(木), 6月12日(金). Topics include optical integration, compact solutions, and AI application in SMT.

ダントツものづくりセミナー 無料 事前登録不要 東7ホール セミナー会場8

Table with 3 columns for dates 6月10日(水), 6月11日(木), 6月12日(金). Topics include DX special sessions, TOC/management sessions, and various industry seminars.

JIEPアカデミックプラザ 無料 事前登録不要		東7ホール セミナー会場9	
6月10日(水)		6月11日(木)	
13:00-13:20		プリント基板のCuダイレクトレーザ加工における絶縁層ガラスロス2枚積層が加工穴直径に与える影響に関する考察 森下 航平 同志社大学大学院	表皮効果損失抑制のための負透磁率材料を用いた円形積層伝送線路に関する研究 宮田 拓実 長野工業高等専門学校
13:20-13:40	低温ヘテロジニアス集積のためのAu薄膜転写を応用した接合面の平滑化およびマイクロパンパ接合の研究 後藤 慎太郎 東北大学大学院工学研究科	左右ボルトねじカウパランス制御機構を有する穴あけ工作機械によるプリント基板のマイクロドリル加工におけるサイクルステップ動作の検討 結城 要 同志社大学大学院	ソフト3Dエレクトロニクス技術により試作した光るクラゲ 加藤 空規 国立大学法人山形大学 大学院有機材料システム研究科
13:40-14:00	USB2.0通信の電磁的情報漏洩実験系の構築と盗聴防止を目的とした漏洩メカニズムの解明 川井 佑真 岡山大学大学院環境生命自然科学研究科	マイクロドリル加工の多目的最適化におけるランダムフォレストを用いた刃先摩耗と穴形状精度の同時予測 喜多 俊介 同志社大学	デザイン思考による見た目の形状変化を活用したPOPディスプレイシステムの開発 阪本 邦夫 甲南大学
14:00-14:20	暗号ハードウェアに対する深層学習サイドチャネル攻撃耐性評価の効率化に向けた検討 中村 幸成 岡山大学大学院環境生命自然科学研究科	マイクロロボットのためのアクチュエータおよび姿勢検討 竹内 流人 日本大学	メカニカルフリー液晶レンズ技術が実現する産業応用 櫻井 靖弘 秋田大学
14:20-14:40	サイドチャネル攻撃対策 AES 暗号の FPGA 実装と深層学習攻撃耐性の評価 光保 怜 岡山大学大学院環境生命自然科学研究科	医工連携に基づく手術支援ロボットの開発 清水 蘭斗 日本大学理工学研究科 精密機械工学専攻	
14:40-15:00	ITO 薄膜を用いた第6世代移動通信システム用7GHz帯透明電磁シールドの検討 佐藤 潤弥 東京工芸大学		半導体産業に向けた低温焼成接合を可能とする銅ナノ粒子系 米澤 徹 北海道大学 大学院工学研究院 米澤研究室
15:00-15:20		熱伝導性を含む接続特性向上とマイクロファイバ低温焼結促進のための脂環式エポキシ樹脂バインダの配合設計 福島 孝典 群馬大学大学院理工学府	糖鎖を用いたPFASフリーの水現像型ボジ・ネガフォトリソの開発 林 飛隆 富山県立大学
15:20-15:40	基板端部に給電点に配置したITO透明広帯域アンテナの放射素子形状に対する放射効率の検討 簡浦 希望 東京工芸大学大学院 工学研究科	動的パーコレーション誘導を用いた3D印刷配線の低抵抗化に対するバインダ化学の役割 井上 雅博 国立大学法人 群馬大学	水平台機構と光を用いた鳥類回避システム 山口 麗 京城大学大学院 工学研究科 機械工学専攻
15:40-16:00	子どもと高齢者を対象とする見守りのためのドノブ電極とウェアラブル機器の間の人体通信の検討 横矢 玄 東京工芸大学大学院	銅系導電性ペーストの材料設計による金属電極界面の電気接続安定化 内田 歩海 国立大学法人 群馬大学	スイッチング電源など閉回路の導線内循環電流について 宝本 学大 信州大学 工学部 工学科 電気電子コース 高効率電力システム 曾根原研究室
16:00-16:20	金属製松葉杖利用時の人体通信における伝送特性劣化低減の検討 山下 幹人 東京工芸大学大学院	ストレッチャブル印刷配線の信頼性向上に向けたバインダ分子設計と抵抗率安定化 岡村 春弥 国立大学法人 群馬大学	
16:20-16:40		液体金属配線-印刷電極界面の反応挙動と接続抵抗の安定性評価：ストレッチャブル回路構築に向けて 羽鳥 統吾 群馬大学	
16:40-17:00		マルチマテリアル化に向けた金属どうし・金属/樹脂の精密接合 小山 真司 群馬大学大学院 理工学府	

ぷりんとはんじゅくセミナー **無料** **事前登録不要** 東7ホール セミナー会場7

6月10日(水)	
13:00-14:00	プリント配線板全般の基礎“ぷりんとはんじゅくI”をもとに解説 榎場 正男 ㈱カヤパオフィス 代表取締役
14:15-15:15	フレキシブル配線板の基礎“ぷりんとはんじゅくVII”をもとに解説 宮崎 博明 元M/Fインフォメーション㈱ 代表
6月11日(木)	
11:00-12:00	プリント配線板設計の基礎 嶋田 茂晴 JPCA認定PWBコンサルタント 1級プリント配線板技能士(設計)
6月12日(金)	
13:00-14:00	実装の基礎“ぷりんとはんじゅくV”をもとに解説 榎場 正男 ㈱カヤパオフィス 代表取締役
14:15-15:15	品質管理の基礎“ぷりんとはんじゅくIII”をもとに解説 安井 博文 安井事務所 PWBコンサルタント

出展者 (NPI) プレゼンテーション **無料** **事前登録不要** ※一部、要事前登録の可能性がございます。 東1・3・7ホール セミナー会場

東1ホール セミナー会場 4		東3ホール セミナー会場 5		東7ホール セミナー会場 10		東3ホール セミナー会場 6 (クローズ)	
6月10日(水)	12:15-12:35 粉体や樹脂表面の濡れ性を改善し、分散性・密着性の向上に繋げるプラズマ親水化学技術をご紹介します。 ㈱魁半導体	11:35-11:55 先端パッケージの開発から量産を見据えたダイレクト露光技術 ㈱オーク製作所	10:55-11:15 正確な故障解析へ!半導体・電子部品向けマイクロ操作技術 ㈱マイクロサポート	6月10日(水)	12:55-13:15 キャリア付き極薄銅箔「MicroThin™」シリーズ及び市場動向のご紹介 三井金属㈱	6月11日(木)	12:55-13:15 iconos™とその応用技術のご紹介 三井金属㈱
12:55-13:15	ダイナトロンが提案する部品実装製品のご紹介 ダイナトロン㈱	14:15-14:35 真空印刷機によるVIAへのペースト充填技術 ㈱セラアコーポレーション/㈱セラアエンジニアリング	11:35-11:55 微細凹凸形成技術で「ガラス表面を機能化」：nanoWave™ 日本電気硝子㈱	6月11日(木)	12:15-12:35 ガラスへの高密着無電解銅メッキ形成プロセス 奥野製薬工業㈱	6月11日(木)	12:15-12:35 AI基板の高速伝送を実現する高精度バックドリル加工技術 三晃技研工業㈱
13:35-13:55	熟練設計者の“勘”をAIで再現する・基板設計自動化の最新アプローチ ㈱オンテック	14:55-15:15 多様化する半導体パッケージ実装を支援するCR-8000 Design Force ㈱図研	12:55-13:15 次世代AIサーバーを支える高周波銅箔—新製品&技術動向 三井金属㈱	6月11日(木)	14:15-14:35 AIサーバー/半導体パッケージ/5G・6G通信/車載レーダー向け樹脂材料の誘電率評価・銅箔の導電率評価とシミュレーションへの応用 EMラボ㈱	6月11日(木)	14:15-14:35 TD-NMR(時間領域NMR)を用いた粉体の濡れ性および高濃度分散体の非破壊評価法の提案 池田 純子 マジェリカ・ジャパン 代表取締役/東北大学多元物質科学研究所 客員准教授
14:15-14:35	AI時代の先端パッケージを切り拓くマスクレス露光~R2R応用まで広がる次世代露光技術~ ㈱ニコン	15:35-15:55 AIサーバー/半導体パッケージ/5G・6G通信/車載レーダー向け樹脂材料の誘電率評価・銅箔の導電率評価とシミュレーションへの応用 EMラボ㈱	14:15-14:35 グラビアオフセット印刷を用いた高精度パターンニングプロセスの実現 ㈱セラアコーポレーション/㈱セラアエンジニアリング	6月11日(木)	15:35-15:55 アンモニアフリー導線酸ナトリウムのPCB PTHプロセス微細穴形成抑制応用 UNITED INITIATORS (SHANGHAI)	6月11日(木)	14:15-14:35 放熱フィルアとしての酸化亜鉛 西川 由唯 堺化学工業㈱ 研究開発本部 小名浜開発部
14:55-15:15	SYSTEMC™610を用いたバルスめっきによるFC-BGA基板の性能向上 MacDermid Alpha Electronic Solutions	10:55-11:15 TGV基板への銅メッキ層の形成プロセス 石原ケミカル㈱	14:15-14:35 イングジェットSR前処理剤 メックエッチボンDCL-8325 メック㈱	6月11日(木)	15:35-15:55 アンモニアフリー導線酸ナトリウムのPCB PTHプロセス微細穴形成抑制応用 UNITED INITIATORS (SHANGHAI)	6月11日(木)	14:20-14:30 新タック化成膜受託塗工サービスについて 村井 徹 新タック化成㈱ 営業本部 上級調査役
10:15-10:35	アンモニアフリー導線酸ナトリウムのPCB PTHプロセス微細穴形成抑制応用 UNITED INITIATORS (SHANGHAI)	11:35-11:55 プラズマ処理を変えよう!「マイルドプラズマ」 島根県産業技術センター	15:35-15:55 熱圧着・ロールプレスの圧力定量化による製品品質・歩留まり向上 富士フィルム㈱	6月12日(金)	12:55-13:15 熱圧着・ロールプレスの圧力定量化による製品品質・歩留まり向上 富士フィルム㈱	6月12日(金)	14:20-14:30 新タック化成膜受託塗工サービスについて 村井 徹 新タック化成㈱ 営業本部 上級調査役
10:55-11:15	当社のサーマルマネジメント製品開発の取り組み タツタ電線㈱	12:15-12:35 AIサーバー/半導体パッケージ/5G・6G通信/車載レーダー向け樹脂材料の誘電率評価・銅箔の導電率評価とシミュレーションへの応用 EMラボ㈱	13:35-13:55 東7ホール セミナー会場 7 10分を0.3秒に変えるDX生産—2000倍速でコストと品質の改善に還元 ㈱電路計画・成徳科技	6月12日(金)	12:55-13:15 電子回路基板用ドリル・ルーターの最新技術情報 ユニオンツール㈱	6月12日(金)	14:30 大阪産業技術研究所
11:35-11:55	現場での計画的な人材教育を実現するためのデジタル活用最前線 Tebiki㈱	12:55-13:15 車載品質で注目された清浄度規格VDA19でも認められたTeknekローラークリーニングによる「はんだ印刷前」異物対策 ㈱ブルックスジャパン					
12:55-13:15	フッ素ガスによる特異な表面改質技術 高松帝酸㈱	12:55-13:15 国内Tier1でも採用 クリーン化で品質向上を実現するレーザー基板分割 ㈱ブルックスジャパン					
13:35-13:55	根上工業の強みと製品のご紹介 根上工業㈱	13:35-13:55 電子回路・部品のアルミ化を無洗浄プロセスで実現するはんだ材料 石川金属㈱					
14:15-14:35	スルファミン酸ニゲルめっきについて~低応力、高速化、非磁性めっき液の開発~ 日本化学産業㈱	14:15-14:35 電子回路・部品のアルミ化を無洗浄プロセスで実現するはんだ材料 石川金属㈱					
15:35-15:55	世界最高レベルのエアレーザー技術 レーザーセル㈱	14:55-15:15 ガラス加工用レーザーシステムの紹介 滝谷工業㈱					

6月12日(金)	
10:15-10:35	アンモニアフリー導線酸ナトリウムのPCB PTHプロセス微細穴形成抑制応用 UNITED INITIATORS (SHANGHAI)
12:55-13:15	PI解析を用いた電源ノイズ対策の極意! ㈱オンテック
13:35-13:55	パワー半導体から6G基板まで:異業種材接合におけるMI活用最前線 MI-6㈱
14:15-14:35	様々な用途として使用されるセラミック 京セラ㈱

魁半導体セミナー **無料** **事前登録不要** 東1ホール JISSO PROTEC 特別講演会場

6月10日(水)	
12:00-12:45	表面改質で実現する材料・部品の機能向上 西田 弥奈 ㈱魁半導体 プロセス開発部 サブチーフ

化学物質伝達ツール解説セミナー **無料** **事前登録不要** 東1ホール JISSO PROTEC 特別講演会場

6月12日(金)	
13:30-14:30	CMPの全体解説と今秋運用開始に向けて 森 伸明 CMP仕様検討委員会 委員長・CMPコンソーシアム
15:00-16:00	自動車向け化学物質伝達ツールIMDS活用の概説 藤本 智之 (一社)日本電子回路工業会 参事

デモンストレーション/体験 (技術提供: ㈱ニフコ) 東7ホール 特設会場

あなたの足、ちゃんと踏ん張れますか?

転倒予防の指標「足把持力」を30秒で測定! 結果判定やトレーニングゲームもできる体験型ツール HAJICHECK (ハジチェック) をぜひお試しください。

人と空間見守りセンサー
人も空間もリアルタイムでモニタリングが可能。空間×人を同時に計測でき、管理・運営の手間とリスクを軽減します。危険エリアを把握可能で、個別センサーで作業者の状況を追跡できます。自動記録で、監査対応・提出資料にもそのまま使えます。

WIRE Japan Showセミナー **無料** **事前登録不要** 東7ホール セミナー会場7・10

6月11日(木)	
14:00-15:00	㈱HClの紹介 ものづくりの現場~海外市場および開発動向について~ 大山 聡 グロスバープ合同会社 代表 井上 政基 ㈱電線新聞社 電線新聞編集長 奥山 浩司 (一社)日本ロボット工業会 理事/ (一社)日本ロボットシステムインテグレーション協会 副会長/ ㈱HCl 代表取締役社長 セミナー会場7
6月12日(金)	
14:00-15:00	ロボットとEVIにまつわる海外と日本の動向について 井上 政基 ㈱電線新聞社 電線新聞編集長 セミナー会場10

出展者 (NPI) プレゼンテーション (eX-tech) **無料** **事前登録不要** 東3・7ホール セミナー会場

6月10日(水)	
13:35-13:55	半導体分野を支える熊本県の機能性表面処理技術 ㈱オジックテクノロジーズ セミナー会場5
6月11日(木)	
11:35-11:55	焼結が“わかる”時代へ:導電性ペーストを進化させるレオ・インピーダンス測定技術 ティー・エイ・インストルメント・ジャパン㈱ セミナー会場11
12:15-12:35	リフロー実装部品の保管環境に対応する信頼性技術の開発 TDK ㈱ セミナー会場11
13:35-13:55	電子デバイスの信頼性を支える物性評価:DMAとレオメーターの活用事例 ティー・エイ・インストルメント・ジャパン㈱ セミナー会場11
14:55-15:15	半導体分野を支える熊本県の機能性表面処理技術 ㈱オジックテクノロジーズ セミナー会場4
6月12日(金)	
11:35-11:55	チップレット/BGA対応!見えない不良を検出するJTAGテスト最前線 アードルシステムサポート㈱ セミナー会場10
12:55-13:15	“なぜ?”を解き明かす材料分析で、製品開発の課題解決へ ㈱カネカテクノリサーチ セミナー会場5
13:35-13:55	歩留まり向上へ、半導体実装を見える化 ㈱JSOL セミナー会場10
14:15-14:35	フレキシブル性をコアとする低誘電・接着・圧電材料の開発 大阪有機化学工業㈱ セミナー会場10
14:55-15:15	半導体分野を支える熊本県の機能性表面処理技術 ㈱オジックテクノロジーズ セミナー会場5

半導体産業展 専門セミナー **無料** **事前登録不要** 東7ホール セミナー会場12

6月10日(水)		6月11日(木)		6月12日(金)	
11:20-11:50	ばらつきとシレを前提としたAIサロゲートとロバスト最適化—CAE-実験-製造データの統合による高信頼デジタルツインと歩留まり改善 計測エンジニアリングシステム㈱	11:20-11:50	製造・物流現場へ浸透するAIの最前線 ~半導体・AIが創る未来~ BHオフィス㈱シンコム		
13:00-13:30	正確な故障解析へ!半導体・電子部品向けマイクロ操作技術 ㈱マイクロサポート	13:00-13:30	人手不足時代を乗り切る「人手不足解消のカギ」特定技能外国人材の採用・定着に向けて ㈱フィールマーケティングシステムズ		ベトナムの半導体産業における優遇政策 FPTジャパンホールディングス㈱

ORIST 次世代高速セミナー **無料** **事前登録不要** 東7ホール セミナー会場主催者企画セミナー ORIST展 (ブース内)

6月10日(水)		6月11日(木)		6月12日(金)	
11:30-11:40	界面が見えないと、なぜ実装は止まるのか?—SFGによる分子レベル評価の手法 花牟禮 慎也 ANVOS Analytics ㈱ 取締役COO	11:30-11:40	高機能樹脂素材のご紹介 長谷川 篤彦 日本化薬㈱ ファインケミカルズ研究所 第1グループ 担当リーダー		世代通信デバイス用材料のレオロジー特性評価 河西 隆太 ㈱アントンパール・ジャパン/ ㈱ビジネスユニットキャラクタリゼーション 粘弾性プロダクト マネージャー
11:40-11:50	めっきプライマー「メタロイド」の石英への適用 中澤 悠人 ㈱イオックス 研究開発部	11:40-11:50	半導体パッケージ基板レーザ加工技術と、フェムト秒レーザ”非加熱加工”応用事例紹介 池本 裕 ㈱クオルテック 新規開発事業部 技術		放熱フィルアとしての酸化亜鉛 西川 由唯 堺化学工業㈱ 研究開発本部 小名浜開発部
11:50-12:00	TD-NMR(時間領域NMR)を用いた粉体の濡れ性および高濃度分散体の非破壊評価法の提案 池田 純子 マジェリカ・ジャパン 代表取締役/ 東北大学多元物質科学研究所 客員准教授	11:50-12:00	高速通信・半導体パッケージを支える樹脂・フィルム資材 ユニチカ株式会社		新タック化成膜受託塗工サービスについて 村井 徹 新タック化成㈱ 営業本部 上級調査役
14:00-14:10	次世代通信デバイス用材料のレオロジー特性評価 河西 隆太 ㈱アントンパール・ジャパン/ ㈱ビジネスユニットキャラクタリゼーション 粘弾性プロダクト マネージャー	14:00-14:10	界面が見えないと、なぜ実装は止まるのか?—SFGによる分子レベル評価の手法 花牟禮 慎也 ANVOS Analytics ㈱ 取締役COO		高機能樹脂素材のご紹介 長谷川 篤彦 日本化薬㈱ ファインケミカルズ研究所 第1グループ 担当リーダー
14:10-14:20	放熱フィルアとしての酸化亜鉛 西川 由唯 堺化学工業㈱ 研究開発本部 小名浜開発部	14:10-14:20	めっきプライマー「メタロイド」の石英への適用 中澤 悠人 ㈱イオックス 研究開発部		半導体パッケージ基板レーザ加工技術と、フェムト秒レーザ”非加熱加工”応用事例紹介 池本 裕 ㈱クオルテック 新規開発事業部 技術
14:20-14:30	新タック化成膜受託塗工サービスについて 村井 徹 新タック化成㈱ 営業本部 上級調査役	14:20-14:30	TD-NMR(時間領域NMR)を用いた粉体の濡れ性および高濃度分散体の非破壊評価法の提案 池田 純子 マジェリカ・ジャパン 代表取締役/ 東北大学多元物質科学研究所 客員准教授		高速通信・半導体パッケージを支える樹脂・フィルム資材 ユニチカ㈱
14:30	大阪産業技術研究所	14:30	大阪産業技術研究所		大阪産業技術研究所

E-Textile/Wearable展セミナー **無料** **事前登録不要** 東7ホール セミナー会場主催者企画セミナー E-Textile/Wearable展 (ブース内)

6月10日(水)		6月11日(木)	
10:30-11:10	椅子は「デバイス」へ。AI×スマートテキスタイルが導くあなたの「正解姿勢」 加藤 幸子 ㈱AZAYAKA JAPAN 代表取締役	11:10-11:50	脳出血からの再起と次世代ウェアラブル:—スマートウェア「COVEROSS®」が変える「リハビリ・リカバリー」の常識— 鈴木 素 hap ㈱ 代表取締役
11:10-11:50	スマートテキスタイル×AIの融合 西谷 龍哲 ㈱Tol Nexus 代表取締役	13:30-14:10	自己修復性・タフネス性を実現したWIZARD Seriesの紹介 中野 浩平 ㈱ユシロ イノベーション推進部研究開発セクション
13:30-14:10	竹由来の炭素繊維が切り拓く次世代導電性素材 瀬戸 祐志 ㈱中津山熱処理 研究開発センター R&B推進部 部長	15:10-15:50	t-テキスタイル製品化研究会のご紹介 佐藤 政孝 t-テキスタイル製品化研究会/ 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 特任技術アドバイザー
14:20-15:00	「未来の服は、あたたかだけでなく、一発熱・センシング・快通性を融合するスマートテキスタイル技術 松本 正秀 ㈱三機コンシス 代表取締役		6月12日(金)
15:10-15:50	t-テキスタイル製品化研究会のご紹介 佐藤 政孝 t-テキスタイル製品化研究会/ 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 特任技術アドバイザー	15:10-15:50	t-テキスタイル製品化研究会のご紹介 佐藤 政孝 t-テキスタイル製品化研究会/ 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 特任技術アドバイザー

AIデバイス展セミナー **無料** **事前登録不要** 東3・7ホール セミナー会場

6月11日(木)	
14:15-15:15	進化するAI時代を勝ち抜くための半導体戦略 大山 聡 グロスバープ合同会社 代表 セミナー会場11
15:30-16:30	AI用半導体パッケージと受動部品の動向 壺 秀樹 ㈱産業タイムズ社 編集委員 (事業開発部 部長) セミナー会場11
6月12日(金)	
14:15-15:00	衛星データを活用した新事業に挑戦 菅谷 智洋 ㈱Tellus セミナー会場6
15:15-16:00	宇宙向けAI&半導体の市場動向 壺 秀樹 ㈱産業タイムズ社 編集委員 (事業開発部 部長) セミナー会場6

3D-MIDパビリオンセミナー **無料** **事前登録不要** 東7ホール セミナー会場9

6月10日(水)	
10:15-10:45	MIDの概要と日本MID協会の活動紹介 吉澤 徳夫 日本MID協会 監事 (三共化成㈱)
11:00-11:30	立体配線形成の可能性を広げるフェムト秒レーザと分子接合技術 目黒 和幸 (地独) 岩手県工業技術センター ものづくりDX推進部 部長
11:45-12:15	電気印刷の紹介 ~新規な電気回路の作製方法~ 富江 崇 ㈱電気印刷研究所 商品開発室
6月11日(木)	
10:15-10:45	MIDの概要と日本MID協会の活動紹介 吉澤 徳夫 日本MID協会 監事 (三共化成㈱)
11:00-11:30	アディティブマニュファクチャリングエレクトロニクス技術 (AME Tech) 富永 亮二郎 ㈱FUJI 開発センター 技術部 課長
11:45-12:15	JEITA・日本MID協会の実装用MIDテクノカルレポート 坂本 一三 電子情報技術産業協会 (JEITA) / 電子実装技術標準化専門委員会 主査
6月12日(金)	
10:15-10:45	MIDの概要と日本MID協会の活動紹介 吉澤 徳夫 日本MID協会 監事 (三共化成㈱)
11:00-11:30	3D-MID &次世代先端半導体パッケージ設計環境 松澤 浩彦 ㈱図研 技術本部 EL 開発部 シニアパートナー
11:45-12:15	世界市場調査「Molded Interconnect Device Market Report (2024-2030:Grand View Research)」の解説 吉澤 徳夫 日本MID協会 監事 (三共化成㈱)

6月10日(水)		6月12日(金)	
最先端パッケージング、基板技術		エレクトロニクスの新たな用途を考えるプログラム	
13:00-14:00	初出展!中空構造で超低損失基板を実現 ULTICIRC (株)村田製作所 通信・センサ事業本部 通信モジュール事業部 プリンシパルエンジニア 池本 伸郎	13:00-13:30	【特別講演】 アーバン・ワイルドライフとゾーニング管理 酪農学園大学 農食環境学群 環境共生学類 野生動物生態学研究室 教授 佐藤 喜和
14:00-15:00	既存PCB工程&フィルム型基板材料を活用したプリント配線板の高周波対応・微細化対応~10um以下の平滑なCu回路を有するプリント配線板製造の新たな選択肢~ パナソニック インダストリー(株) メカトロニクス事業部 ファインエレメントビジネスユニット 事業企画部 事業企画二課 課長 森田 陽介		エレクトロニクスが変える野生動物の生態調査 NPO法人 南知床・ヒグマ情報センター 主任研究員 藤本 靖
15:00-16:00	半導体製造装置で使われるファインセラミックスと単結晶サファイア技術 京セラ(株) ファインセラミック事業本部 機構部品事業部 機構部品商品技術部 責任者 本庄 隆人 京セラ(株) ファインセラミック事業本部 単結晶事業部 技術部商品技術課 商品技術係 梅原 幹裕 高度化する顧客ニーズへの統合最適化アプローチ(セラミックパッケージ技術の活用事例)~お客様の課題に寄り添う、最適な選定と設計へのアプローチ~ 新納 範高 京セラ(株)	13:30-14:30	デジタルで挑む鳥獣被害対策! マクセルフロンティア(株) DMS事業部 榎 大・横山 禎秀 イーメーカーが考える社会貢献型エレクトロニクス イーメーカー(株) 代表取締役 藤井 誠
		14:40-16:00	エレクトロニクスの新たな用途を考える座談会 「異分野融合が拓くアプリケーション」 各講師
特別展示開催中!		特別展示開催中!	
6月10日(水)~12日(金) 10:00~17:00 東7ホール(7C-01~05)		6月10日(水)~12日(金) 10:00~17:00 東7ホール(7B-06)	

主催者企画：光電融合セミナー・展示 (特別協力：(株)オプトロニクス社) **無料** 事前登録不要

東7ホール 特設会場

6月11日(木)		パネル展示	
13:30-14:30	光電融合基礎の基礎・拡大する背景とその適用分野 山口 望 (株)オプトロニクス社 専務取締役	【光電融合に向けたガラスソリューション】 日本電気硝子(株)	
	データセンター市場最新動向と周辺産業の役割の変化 佐々木 健一 (株)野村総合研究所 グローバル製造業コンサルティング部 チーフコンサルタント	【様々な異種ウエハの室温接合技術：原子拡散接合法ADB】 東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室	
	CPOに関連する技術・産業動向 鎌塚 洋史 (株)野村総合研究所 グローバル製造業コンサルティング部 エキスパート	【光導波路光学特性測定装置(メーカー：シナジーオプトシステムズ社)】 稲畑産業(株)	
	光電融合に対する当社の取り組み 片桐 規貴 新光電気工業(株) 開発統括部 主席部長	【新規用途向けMicroThin™】 三井金属(株)	
	【情報処理フォトニクス】光テクノロジーロードマップ 杉立 厚志 (一財)光産業技術振興協会 開発部長代理		
	【パネルディスカッション】 テーマ：市場予想、光電融合の技術的課題、光電融合のエコシステム 司会：(株)オプトロニクス社		

次回、電子機器トータルソリューション展 2027

ご出展、スポンサー申込等についてご検討の際は、本部事務局(JPCA)までお気軽にお問合せください。



電子機器2027
トータルソリューション展

The Total Solution Exhibition for Electronic Equipment 2027

2027. 6. 2 Wed. → 4 Fri.

東京ビッグサイト 東展示棟

Tokyo Big Sight, East Exhibition Halls

本部事務局 一般社団法人 日本電子回路工業会

Organizer: JPCA - Japan Electronics Packaging and Circuits Association

展示会に関するお問い合わせ / Inquiry
TEL: 03-5310-2020 E-mail: show@jpcac.org

www.jpccashow.com